

下記の講演動画はイベント期間中 24 時間いつでも視聴可能です

製品開発ロードマップ

RD1 CR-8000 Design Gateway/ System Planner ロードマップ

MBSE とのトレーサビリティ実現、AI 活用、設計品質向上など最新の取り組みを紹介

株式会社図研
技術本部 EE 開発部 部長 大崎 義徳



大規模化、複雑化が進むシステム設計においては、より早いタイミングで設計品質の向上や作り込みを行うことが重要なテーマとなっています。本セッションでは、ブロック設計や回路検証、コンストレイントドリブン設計環境の強化、AI を活用した新しいデザインレビュー環境など System Planner、Design Gateway の最新取組みとロードマップならびに、MBSE などを活用した上流での要求検討や定義から回路設計までのトレーサビリティを実現する GENESYS-CR との連携についてご紹介します。

RD2 CR-8000 Design Force ロードマップ Part1

AI 活用による革新的新機能リリース計画、システムレベル PCB 設計環境の着実な進化

株式会社図研
技術本部 EL 開発部 部長 畑 直樹



電子機器設計の難易度は年々増し、さらにワークスタイルにおいてもリモートによる設計など大きく変化しようとしています。CR-8000 Design Force はそのような変化に柔軟に対応すべく、PCB 設計を強力に支援する機能開発を行っています。本セッションでは CR-8000 Design Force の最新機能と将来計画について、また今後 AI 技術を活用した機能群のリリースを控えておこれらを中心にご紹介いたします。

RD3 CR-8000 Design Force ロードマップ Part2

大規模化する電子機器、新ワークスタイルに対応する次世代エレメカ協調・解析環境

株式会社図研
技術本部 EL 開発部 EL2 セクション セクションマネージャ 吉島 憲輔



大きなワークスタイルの変革により、設計環境も中央集権型から地方分散型へ変化しています。一部のエキスパートに解析検証業務が集中している現状は、設計フローの改善において大きなネックになっています。本セッションでは、新解析モジュールが統合された Design Force が設計者個々にローカライズされた設計環境としてどのように活用いただけるかをご紹介します。またエレメカ領域の取り組みとしてメカデータの活用事例や Ansys 協調の次期開発テーマ案についても触れさせていただきます。

RD4 CR-8000 Design Force ロードマップ Part3

半導体パッケージやモジュール部品の先端実装を支援する SOC/PKG/PCB 協調設計

株式会社図研
技術本部 EL 開発部 EL4 セクション シニア・パートナー 古賀 一成



世界の生活様式が大きく変わり、今後の経済活動の不透明感が強まる一方、2021 年の半導体市場予測は上方修正され、さらなる技術革新が注目されています。本セッションでは、今後注目される InFO や chiplet などの先端半導体パッケージから従来からの低コストなワイヤボンディングタイプのパッケージ、さらにはパワーモジュールに対応した CR-8000 Design Force の機能をご紹介します。また、東工大との 3 次元半導体積層に関する共同研究開発の最新情報をお伝えします。

RD5 CR-8000 DFM Center ロードマップ

FPC 設計製造リードタイムを大幅短縮する最新機能と多様な分業形態への対応

株式会社図研
技術本部 EL 開発部 DFM セクション セクションマネージャ 弦間 一泰



国内の基板製造、部品実装のエンジニアリング部門では依然としてベテラン技術者に依存している状況が見受けられます。特に FPC 製造では Rigid 基板に比べ取り扱う部材が非常に多く、また形状もさまざまなためベテラン技術者への依存が顕著で、さらに各部門への伝達にはドキュメントを用いるという全てマンパワーに頼った形で海外メーカーと競い合っています。本セッションでは、ものづくり大国 = 日本を持続可能にする、人依存からの脱却および FPC 製造準備のリードタイムを大幅に短縮することができる CR-8000 DFM Center の最新機能をご紹介します。

RD6 DS-2 ロードマップ Part1 (DS-CR)

Web/ ナレッジ、PLM/ERP 連携などエンジニアリングデータを活用する実用的 DX 推進

株式会社図研
技術本部 PLM 開発部 部長 高木 良亮



COVID-19 に限らず、各種災害、国際情勢、新テクノロジーの到来とあらゆるものを取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難な時代に入りました。この時代を乗り切り、リードするには、デジタルデータを活用した的確な状況判断が必須となります。そのために、エンジニアリングプロセスやデータはどうあるべきか、部品供給不足の対策などを例に、Web やナレッジの活用、エンタープライズ PLM との連携など、より具体的に実践的な DX 推進のアプローチをご紹介します。

RD7 E3.series ロードマップ

マシナリー電装設計環境における多様な図面・帳票形式に対応した着実な進化

株式会社図研
技術本部 A&M 開発部 取締役 部長 早乙女 幸一



Industry4.0 に代表される技術改革が産業機器、電子機器、工場 / プラントなどのマシナリー電装設計環境に広がりつつあります。搭載センサーや機能の増加に伴う製品の複雑化が進む中で、さまざまな図面・帳票を別々に作成して整合を取る従来の設計環境では図面・帳票間の不整合、設計工数の増加などさまざまな課題が生じています。本セッションでは、シングルポジトリを用いて多様な図面・帳票間のダイナミックな整合性維持を提供し、これらの課題を劇的に解決する E3.series の有効性、3D-MCAD との有機的な連携などの最新機能をご紹介します。

RD8 DS-2 ロードマップ Part2 (DS-E3)

マシナリー / トランスポート電装設計プロセス革新によるフロントローディング実現

株式会社図研
技術本部 PLM 開発部 部長 高木 良亮



顧客志向が強まり多品種少量生産が進む昨今、電装設計プロセス革新によるフロントローディングの実現は、ものづくり企業の至上命題となってきました。マシナリー領域向け『DS-E3、s』、トランスポート電装設計領域向け『DS-E3.i』による各々のプロセスに特化した電装設計支援プラットフォームでのトレーサビリティ環境やモジュール設計環境、企画 / 購買 / 製造との連携強化環境など、設計プロセス革新に向けたアプローチをご紹介します。

RD9 MBSE モデリングツール GENESYS

インダストリー分野に向けた GENESYS 機能強化、電子・電気・電装設計との連携実現

株式会社図研
事業本部 PI 推進部 部長 稲石 浩通



COVID-19 の影響が続くなか、対面での会話や連携は益々困難になっています。これまで以上にチームと各々の専門分野連携を強化するためのシステムズエンジニアリングは重要になっています。GENESYS はステークホルダーや協調者、チームメンバー、ドメインエンジニアを結び付ける最適なプラットフォームとなっています。図研と Zuken Vitech 社が提案する MBSE ソリューションと、今後の MBSE モデリングツール GENESYS のロードマップ、CR-8000 との連携をご紹介します。